

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 1 区分

【発行日】平成24年6月7日(2012.6.7)

【公開番号】特開2011-2390(P2011-2390A)

【公開日】平成23年1月6日(2011.1.6)

【年通号数】公開・登録公報2011-001

【出願番号】特願2009-147061(P2009-147061)

【国際特許分類】

G 0 1 K 1/14 (2006.01)

G 0 1 K 7/18 (2006.01)

【F I】

G 0 1 K 1/14 L

G 0 1 K 1/14 E

G 0 1 K 7/18 A

【手続補正書】

【提出日】平成24年4月12日(2012.4.12)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 3】

従来の検査装置は、例えば図 3 に示すように、互いに隣接するローダ室 1 及びプローバ室 2 を備えている。ローダ室 1 は、複数枚のウエハ W をカセット単位で収納するカセット収納部と、カセットからウエハ W を一枚ずつ搬出入するウエハ搬送機構と、ウエハ搬送機構によってウエハ W を搬送する間にウエハ W をプリアライメントするプリアライメント機構と、を備えている。プローバ室 2 は、図 3 に示すように、ウエハ W を保持し X、Y、Z 及び 方向で移動可能に構成されたウエハチャック 3 と、このウエハチャック 3 上のウエハ W に形成された複数の電極パッドに接触する複数のプローブ 4 A を有するプローブカード 4 と、このプローブカード 4 をカードホルダ（図示せず）によって固定する固定機構 5 と、プローブカード 4 とテストヘッド T とを電氣的に接続する接続リング 6 と、を備え、制御装置の制御下でウエハ W に形成された各デバイスの電氣的特性検査を行なうように構成されている。尚、図 3 において、7 はウエハチャック 3 と協働してウエハ W とプローブカード 4 との位置合わせを行うアライメント機構で、7 A は上カメラ、7 B は下カメラであり、8 はプローブカード 4 の固定機構 5 が装着されたヘッドプレートである。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 2 3】

また、第 2 の貫通孔 1 3 B は、図 2 の ( a )、( b ) に示すように、第 1 のネジ部材 1 5 の雄ネジが貫通する小径孔 1 3 B<sub>1</sub> と、小径孔 1 3 B<sub>1</sub> から拡径し、第 1 のネジ部材 1 5 の頭部が収納される大径孔 1 3 B<sub>2</sub> と、からなり、小径孔 1 3 B<sub>1</sub> と大径孔 1 3 B<sub>2</sub> の境界に第 1 のネジ部材 1 5 の頭部が係止される段部が形成されている。そして、小径孔 1 3 B<sub>1</sub> は、第 1 のネジ部材 1 5 の雄ネジが螺合するようにチャックトップ 2 1 に形成された雌ネジに対応して形成されている。第 1 のネジ部材 1 5 の頭部が収められた第 2 の貫通孔 1 3 B の大径孔 1 3 B<sub>2</sub> の残余の空間には耐熱、耐寒性、耐衝撃性等に優れた樹脂、例

例えば R T V (Room Temperature Vulcanizing Rubber) ゴムが充填されている。また、R T V ゴムは、固定用ブロック 1 3 の表面にコーティングされていると共に固定用ブロック 1 3 とチャックトップ 2 1 を接着している。